



2026年9月17日～19日に開催されます「SEMICON India 2026」に出展いたします
皆様のご来場お待ちしております。

出 展 内 容

【 新機種 パネルレベルパッケージ対応 PLP-700 】

サイズが最大700mm×700mmに対応するパネルレベルパッケージ用の最新設備(PLP-700)のパネル展示を中心に、半導体設備のご提案を致します。

＊PLP-700 詳細情報は SEMICON India 2026 会場にて

【 新機種 12 インチ用マルチワイヤーソー MWS-SiC12F 】

【 難削材対応研削装置 GLP-150 】

大口径インゴット（φ12インチ対応※最大14インチまで）切断用の最新型マルチワイヤーソー MWS-SiC12F、難削材対応研削装置 GLP-150 を中心に、切断加工機のご提案を致します。

＊MWS-SiC12F、GLP-150 の詳細情報は SEMICON India 2026 会場にて

<会場>



双日マシーナリーブース
Booth No. H4021